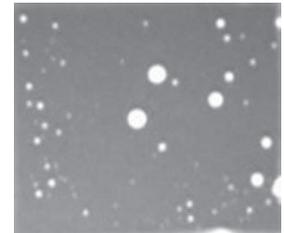


ボイドフリー

Voids free



温度プロファイル



大気はんだ付け



真空はんだ付け

真空式リフローはんだ付け装置 RF-210V Vacuum Reflow Soldering Unit

RF-210Vは高真空環境でリフローはんだ付けを行います。本装置は実験・試作や小ロットの生産用、超低価格の真空式リフローはんだ付け装置です。

パワー半導体やパワーモジュールなど、大電流素子のリフローはんだ付けに要求される、ボイドを数パーセント以下に抑えるボイドフリーはんだ付けができます。

特長

- ・-95kPa(G)以下の高真空でリフローはんだ付けを行います。
- ・Max400°C、Max150mm×150mmのワークまで対応します。
- ・ホットプレート加熱1ゾーン、冷却1ゾーンの2ゾーン式真空リフロー装置です。
- ・窒素(N₂)やグリーンガス(N₂+H₂)も使用できます(ガス雰囲気はんだ付け)。
- ・真空環境でのはんだ付けを観測窓から見る事ができます。

仕様

- ・加熱部 : 1ゾーン ホットプレート 150mm×150mm 1.1kW
ホットプレートによるワーク下部からの直接加熱。
- ・冷却部 : 1ゾーン 自然空冷プレート 150mm×150mm
冷却プレートによるワーク下部の直接冷却。
- ・加熱温度 : Max400°C
- ・搬送方式 (コンベヤ) : キャリアバー(ワーク後押し金具)方式、
またはシートキャリア方式。
(0.125mmtテフロンシート または 0.03mmt SUS304シート)
- ・真空源 : 真空ポンプ Max-98kPa(G)
- ・真空度 : -95kPa(G) 所要時間: 150sec(大気圧から)
- ・チャンバー : (L)395×(W)340×(H)105mm
ワークエリア:(L)300×(W)150×(H)55mm
- ・観測窓 : 105φ(リフロー部)
- ・対応ガス : ガス雰囲気はんだ付け: N₂またはN₂+H₂(3-4%)
- ・制御 : タッチパネル式シーケンサー
- ・センサー端子 : 温度プロファイル測定用センサー端子 3CH
- ・安全装置 : 漏電/過電流ブレーカー、非常停止スイッチ
- ・電源 : 単相200V/220V/240V 1.5kW 50/60Hz
- ・外形寸法 : (W)600×(D)800×(H)860mm
- ・重量 : 約135kg

適合ワーク

- ・Max(W)150×(L)150×(H)50mm、Max300g
- ・金属、セラミックスなど底面が平らな物。

用途

- ・パワー半導体のダイボンディング。
- ・ソーラセルのはんだ付け。
- ・パワーモジュールのリフローはんだ付け。
- ・金属基板のリフローはんだ付け。



株式会社日本パルス技術研究所
〒372-0804 群馬県伊勢崎市稲荷町425-3
TEL 0270-23-1031 FAX 0270-23-1943
<http://www.jpl.co.jp/> info@jpl.co.jp